



**PALTEK、デジタルメディアプロフェッショナルと販売代理店契約を締結し、  
DMPのエッジAI FPGA モジュール「ZIA™ C3」の販売を開始  
～ 産業用IoTのエッジAI化を加速 ～**

株式会社PALTEK(本社:横浜市港北区、代表取締役社長:矢吹尚秀、証券コード:7587、以下PALTEK)は、GPU、AI技術を中心としたIPライセンス、SoC/モジュール販売、および開発委託サービスを手掛ける株式会社デジタルメディアプロフェッショナル(本社:東京都中野区、代表取締役社長CEO:山本達夫、証券コード:3652、以下DMP)と販売代理店契約を締結し、DMPが開発したエッジAI FPGAモジュール「ZIA™ C3」の販売を開始します。

現在、AIはディープラーニングの活用で、画像認識、音声・言語認識、ロボットなどの運動の習熟など実用的に応用できる範囲が拡大しています。このディープラーニングはクラウド側にAIエンジンが置かれ、データをエッジ側からアップロードすることが多いですが、今後IoTがさらに普及すると通信量やデータ容量の増大、処理遅延によるリアルタイム性の低下、通信環境の悪化によるシステムの信頼性の低下、セキュリティ面での堅牢性の低下など課題が認識されてきました。これらの課題を解決する方法として、現場に近いところで処理を行うエッジコンピューティングが注目されています。

DMPは、エッジコンピューティングのAI化の実現に求められる、小型、高性能と低消費電力を両立したAIプロセッサ「ZIA™ DV700」および「ZIA™ DV500」を開発して提供しています。このディープラーニングの推論処理をFPGAにオフロードして実行することで処理性能の高速化、消費電力軽減が実現できます。

PALTEKはDMPのエッジAI FPGAモジュールを取り扱うことで、エッジAIに興味を持つ産業、医療、セキュリティなどの電子機器メーカーの製品に対して、迅速にAI機能を実装することが可能になります。また、FPGAを活用したことのないソフトウェア製品をソリューションとして販売している会社やシステムインテグレータに対しても、エッジAIに対する最適なソリューションを提供することができます。

株式会社デジタルメディアプロフェッショナル 代表取締役社長CEO 山本達夫氏は次のように述べています。

「FPGA、ハードウェア プログラマブル SoC、ACAPを提供するザイリンクス社の代理店であるPALTEKを当社のエッジAI FPGAモジュール「ZIA™ C3」の代理店として迎えられることを大変嬉しく思います。ロボットやFAといった産業機器向けに豊富な実績を持つPALTEKの販売力および技術サポートは、当社のAI FPGAモジュールビジネスを拡大し、お客様、PALTEK、当社をWin-Winの関係に導いてくれると考えております。」

株式会社PALTEK 代表取締役社長 矢吹尚秀は次のように述べています。

「株式会社デジタルメディアプロフェッショナルと販売代理店契約を締結し、エッジAI FPGAモジュール「ZIA™ C3」の販売を開始できることを大変うれしく思います。これにより、お客様へのAIソリューションの提供を加速することができ、従来からお付き合いいただいている電子機器メーカー様のほか、ソフトウェア製品をソリューションとして販売している会社様に対しても幅広く提案活動を展開することが可能となります。」

## ■エッジAIモジュール「ZIA™ C3」について

「ZIA™ C3」は、コンパクトで低消費電力かつ高性能なAI推論処理を完成されたAI FPGAモジュールで、ファクトリーオートメーション、物流における自立ロボットや農機、建機といった産業車両の自動運転、防犯、小売り、発電、医療などでのリアルタイムなデータ解析といった幅広い分野において、エッジAIシステムを短期間で構築することを可能にします。



ZIA™ C3

### 【製品の特長】

1) 長期供給面で実績のあるハードウェア プログラマブルSoCを搭載  
「ZIA™ C3」は、製品寿命の長い産業機器などにおいても安心してご使用いただけるように、メインプロセッサに長期供給面で実績のあるザイリンクス社製 SoCである Zynq® UltraScale+™ MPSoC を使用しています。

2) 省電力かつ高性能

「ZIA™ C3」は、ディープラーニングの推論処理に特化したDMP製AIプロセッサ「DV700」を搭載。GPUベースの他社製品と比較し、主要ネットワークのベンチマークにおいては、約6分の1の動作周波数において最大4倍の処理性能を達成するなど、極めて高い電力性能効率を実現しています。

3) 柔軟性

AI技術は日々急速に進化しており、ハードウェアもその進化に直ちに対応していく必要性和、アプリケーション毎の最適化が求められます。FPGAは、他の半導体デバイスにはないハードウェアの書き換え可能という大きな特徴を有しており、AIの技術進化やアプリケーション毎の異なる要求に柔軟に対応することが可能です。

またハードウェア書き換え機能を使うことで、設置場所におけるハードウェアレベルの機能追加などをより柔軟に行うことが可能です。

4) 使い勝手の良さ

FPGAモジュールと合わせてSDK/Toolを提供。お客様はハードウェアを意識する必要なく学習済みモデルをAIモジュールで動作可能。CaffeやKerasといった汎用的なAI開発フレームワークをサポートしています。

### 【提供開始】

キャリアボードとZIA™ C3モジュールで構成されるZIA™ C3 Development Kitは、198,000円（税抜き価格）で受注を開始し、11月末から順次出荷する予定です。

ZIA は株式会社デジタルメディアプロフェッショナルの登録商標です。

ザイリンクスの名称および Zynq、その他本プレスリリースに記載のブランド名は米国およびその他の各国のザイリンクスの登録商標または商標です。その他すべての名称は、それぞれの所有者に帰属します。

### 株式会社デジタルメディアプロフェッショナルについて:

DMP は、2002 年 7 月の創業以来、ビジュアル・コンピューティング分野で世界的なリーディングカンパニーになることを目指して、組込機器向けの高性能かつ小型 GPU および AI 技術の研究開発を続けています。世界初や世界最小といった他社には真似のできないビジュアル・コンピューティング製品を次々と世に送り出し、ゲーム機やカメラといった民生製品や自動車、OA 機器、産業機器、ヘルスケア製品などあらゆる分野に貢献を続けてまいります。

DMP に関する詳細は、<https://www.dmprof.com/jp/> をご覧ください。

### 株式会社PALTEKについて:

PALTEKは、1982 年の創業以来、日本のエレクトロニクスメーカーに対して国内外の半導体製品の販売のほか、ハードウェアやソフトウェア等の設計受託サービスも提供し、お客様の製品開発のパートナーとして仕様検討から試作開発、量産までサポートしています。PALTEKは、「多様な存在との共生」という企業理念に基づき、お客様にとって最適なソリューションを提供することで、お客様の発展に貢献してまいります。

PALTEKに関する詳細は、<https://www.paltek.co.jp> をご覧ください。

---

■この件に関するお問い合わせは下記へお願いします。

1: ニュースリリースに関するお問い合わせ

担当者 : 広報担当 柴崎 由記  
メールアドレス : [pr@paltek.co.jp](mailto:pr@paltek.co.jp)  
所在地 : 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 6F  
電話 : 045-477-2072 FAX : 045-477-2012

2: 製品に関するお問い合わせ

担当者 : FPGA ソリューション事業部  
メールアドレス : [info\\_pal@paltek.co.jp](mailto:info_pal@paltek.co.jp)  
所在地 : 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 6F  
電話 : 045-477-2008 FAX : 045-477-2010